산업통상자원부 http://www.motie.go.kr	보 도 자 료	정부혁신 보다나은 정부

2019년 6월 25일(화) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
(인터넷, 방송, 통신은 6. 25.(화) 오전 6시 이후 보도 가능)

배포일시	2019. 6. 24.(월)	담당부서	반도체디스플레이과
담당과장	박종원 과장(044-203-4270)	담 당 자	김성환 주무관(044-203-4276)

시스템반도체 산업 성장을 위한 맞춤형 인재양성 추진
- 「시스템반도체 비전과 전략」 인력부문 후속조치 -

□ 산업통상자원부(장관: 성윤모)는 6.25(화) 강원대 등 13개 대학*, 시스템반도체설계기업(팹리스), 반도체설계교육센터(IDEC), 한국전자통신연구원(ETRI), 한국산업기술진흥원(KIAT) 등과 함께 **시스템반도체 설계인력 양성을 위한 설계전공트랙과정 출범식을 개최하였음**

* **시스템반도체 설계전공트랙 개설 13개 대학** : 강원대, 건국대, 군산대, 금오공과대, 서경대, 숭실대, 울산과기원, 이화여대, 전북대, 중앙대, 청주대, 충북대, 홍익대

【 시스템반도체 설계전공트랙 출범식 개요 】

- ㅇ **일시/장소** : '19. 6. 25(화) 10:00~10:50 / 한국반도체산업협회(판교)
- ㅇ **참석자** : (산업부) 정승일 차관 (학계) 김창수 중앙대 총장 등 13개 대학 관계자 (업계) 최원 어보브반도체 대표 등 6개 팹리스 기업 (유관기관) 남기만 반도체산업협회 부회장, 김명준 전자통신연구원 원장, 박인철 반도체설계교육센터 소장 및 대학생 등 약 90여명
- ㅇ **주요내용** : 시스템반도체 설계전공트랙 추진계획(반도체협회) 등 발표, 산·학·관 간 설계전공트랙 운영협약서 체결

□ **금년 2학기부터 13개 참여 대학의 3학년을 대상으로 운영**될 시스템반도체 설계전공트랙과정은

ㅇ 전자공학과 등 기존 반도체 유관학과에 **반도체 설계 특화과목(반도체 공정이론, 반도체 설계 및 제작 등)을 추가로 개설**하여, 이를 이수한 학생들이 팹리스 등 반도체설계기업에 취업 후 별도의 추가 교육없이 곧바로 실무에 투입될 수 있도록 하는 것으로,

ㅇ 이를 통해 **'21년 이후 매년 200명 이상의 반도체 설계인력이 배출**될 것으로 기대됨

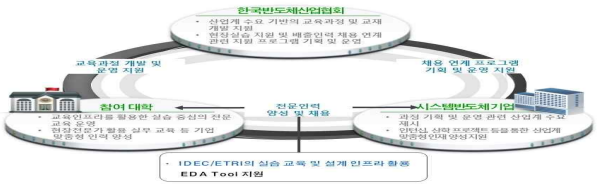
□ 이번 **설계전공트랙 과정의 실효성 있는 운영**을 위하여

ㅇ **산업부는** 반도체설계교육센터(IDEC) 및 한국전자통신연구원(ETRI)과 연계하여 참여 대학생들이 **설계 프로그램(EDA Tool)을 실습해 볼 수 있도록 지원**할 계획이며,

* EDA(Electronic Design Automation) Tool : 반도체 설계에 필수적인 소프트웨어 프로그램

ㅇ **반도체산업협회**도 참여 대학(13개) 교수 및 기업의 인사·교육 담당자들과 함께 **산학협의체를 구성**하여 **산업계에서 요구하는 교육내용이 전공과정에 반영될** 수 있도록 팹리스 기업들을 대상으로 한 **심층 인터뷰 및 교육수요 조사 등을 지속적으로 진행**할 계획임

< 시스템반도체 전공트랙 운영 개념도 >



□ **산업부 정승일 차관은** 격려사를 통해 "이번 시스템반도체 설계전공트랙과정 개설은 **지난 4월말 발표된 시스템반도체 비전과 전략의 후속조치**로서,

ㅇ 전체 반도체시장의 절반 이상을 차지하는 시스템 반도체 분야의 인력양성이 체계적으로 이루어 질 수 있도록 **정부도 가능한 모든 지원을 아끼지 않겠다"**라고 언급함

【붙 임】 1. 시스템반도체 설계전공트랙과정 출범식 개요
2. 시스템반도체 설계전공트랙과정 운영계획

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락
이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 반도체디스플레이과 김성환 주무관(☎ 044-203-4276)에게 연락주시기 바랍니다.

참고 1 시스템반도체 설계전공트랙과정 출범식(안)

□ 행사개요

○ **(일시/장소)** '19.6.25(화) 10:00~10:50 / 한국반도체산업협회(판교)

○ **(참석자) 차관님**, 참여대학* 총장 및 교수, 학생, 시스템반도체 기업 관계자 등 90여명

* 13개 대학(강원대, 건국대, 군산대, 금오공대, 서경대, 숭실대, 울산과기원, 이화여대, 전북대, 중앙대, 청주대, 충북대, 홍익대_가나다 순)

○ **(주요내용)** 산·학·관, 유관기관과 설계전공트랙과정 협약서 체결

- 반도체 업계 수요조사를 통해 참여대학에 교육과정을 개설하고, 이론교육 및 설계실습·실제 칩제작 등을 학부생* 대상으로 지원

* 참여대학의 3학년 학부생을 대상으로 '19년 2학기에 선발하여 '21년부터 연간 200여명 이상 인력 배출 계획

□ 세부일정(안)

시간		내용	비고
09:45~10:00	`15	**환담**	대학 총장 및 기관장
10:00~10:05	`5	개회 및 참석자 소개	한국반도체산업협회
10:05~10:08	`3	환영사	남기만 부회장
10:08~10:11	`3	**격려사**	**차관님**
10:11~10:16	`5	시스템반도체 전공 트랙 과정 총괄 추진 계획 발표	한국반도체산업협회
10:16~10:21	`5	운영 사례 및 향후 계획 발표	전북대
10:21~10:30	`9	시스템반도체 설계·시연	참여대학 학부생
10:30~10:50	`19	협약서 서명식**(기념촬영)**	산업부, KIAT, IDEC, ETRI, 참여대학, 반도체협회
10:50	-	폐회	-

참고 2 시스템반도체 설계전공트랙 운영계획(안)

【 교육프로그램 】

○ **(과정 개발)** 기 수행한 교육 수요조사 및 시스템반도체기업 심층인터뷰 내용을 바탕으로 교육과정 도출

○ **(과정 개설)** 참여대학에 시스템반도체 전공트랙과정 개설 및 운영

≪ 과정 개요 ≫

【목 적】 시스템반도체 설계 관련 학사급 인재 양성 확대를 통해 팹리스 채용 연계 및 석사 진학 유도

【운 영】 반도체설계 관련 학과(전자/컴퓨터/반도체공학 등) 학부생 대상 참여학생 선발 및 2년간 주전공 및 시스템반도체 연계 과정 이수



* 시스템반도체 연계 과정 : 반도체공학, 반도체설계 이론/실습, 공정 이론/실습, EDA Tool 실습, 칩설계 프로젝트

【 업계 참여 】

○ **(전문인력 양성)** 산업계 수요 기반의 교육과정·교재 개발 지원, 교육 인프라 지원 등을 통해 우수 인재 양성에 기여

○ **(채용 연계)** 산업계 필요 인력 수요 제기 및 실무형 인재 양성 지원 (인턴십, 교육성과 평가 등)을 통해 배출 인력 채용

【 기타 지원내용 】

○ **(실습교육)** IDEC/ETRI를 통한 교육용 **설계 Tool 활용 실습 교육** 및 설계 프로젝트 수행, 학부생 대상의 **MPW* 지원 방안 마련**

* MPW (Multi Project Wafer) : 웨이퍼 1장에 여러 종류의 칩을 제작하여 반도체 성능검증

○ **(산학협의체)** 시스템반도체 기업 인사/교육 담당자 및 참여대학 교수로 구성된 산학협의체 운영으로 산·학 간 소통을 통해 트랙과정 완성도 제고

【 기대효과 】

○ **(우수인재)** 시스템반도체 설계에 특화된 학사급 인재 양성을 통해 **'일할 준비가 된' 실무형 인재의 채용 연계** 및 석사 진학생 확대